

TAZMO

タツモ株式会社 決算説明資料

2026年12月期 第2四半期

2026年8月10日

証券コード 6266

会社案内ダウンロード



<https://tazmo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/company%20guide.pdf>

INDEX

目次



1. 2026年12月期第2四半期 連結業績
2. セグメント別業績
3. 市場（顧客）の状況
4. 補足資料



1

2026年12月期第2四半期 連結業績

売上高

12,684百万円

前年比 △24.4%

営業利益

123百万円

前年比 △95.1%

経常利益

270百万円

前年比 △88.6%

親会社株主に帰属 する中間純利益

35百万円

前年比 △97.8%

■ 概況

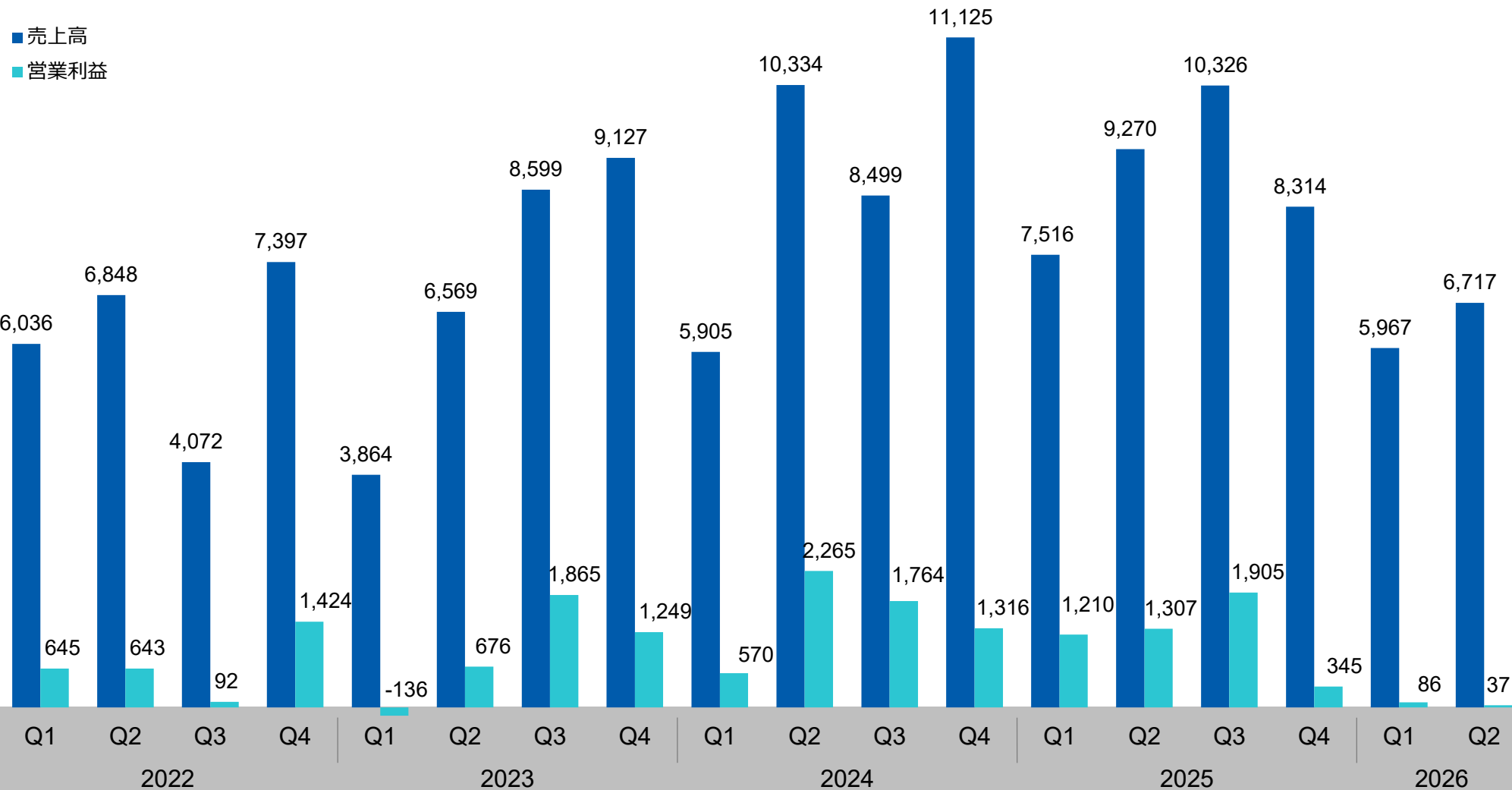
- 前年比で減収減益。半導体装置、搬送装置、表面処理用機器事業で売上が計画未達となった。利益については、売上高の減少、未検収装置の評価減、原価増加が判明した装置の原価増加分の引当て等により計画を大きく下回る結果となった。
- 半導体装置と搬送装置、表面処理用機器事業で受注が大きく伸びた。四半期・通期ともに過去最高の受注高となった。

半導体装置、表面処理用機器事業での検収の遅れなどにより売上高は計画未達。利益面でも検収遅れによる売上高減少、未検収装置の評価減、原価増加分の計上等により大幅な計画未達。

(百万円)	2025年12月期 Q2 実績	2026年12月期 Q2		前期比 増減率(%)	当初 2026年12月期 中間計画	当初中間 計画比 (%)	2026年12月期 通期計画	通期計画比 進捗率(%)
		実績	売上比(%)					
売上高	16,787	12,684	—	△24.4	15,570	81.5	35,500	35.7
売上総利益	5,231	3,598	28.4	△31.2	—	—	—	—
営業利益	2,517	123	1.0	△95.1	890	13.8	3,600	3.4
経常利益	2,384	270	2.1	△88.6	800	33.9	3,500	7.7
親会社株主に 帰属する 中間純利益	1,645	35	0.3	△97.8	600	6.0	2,500	1.4

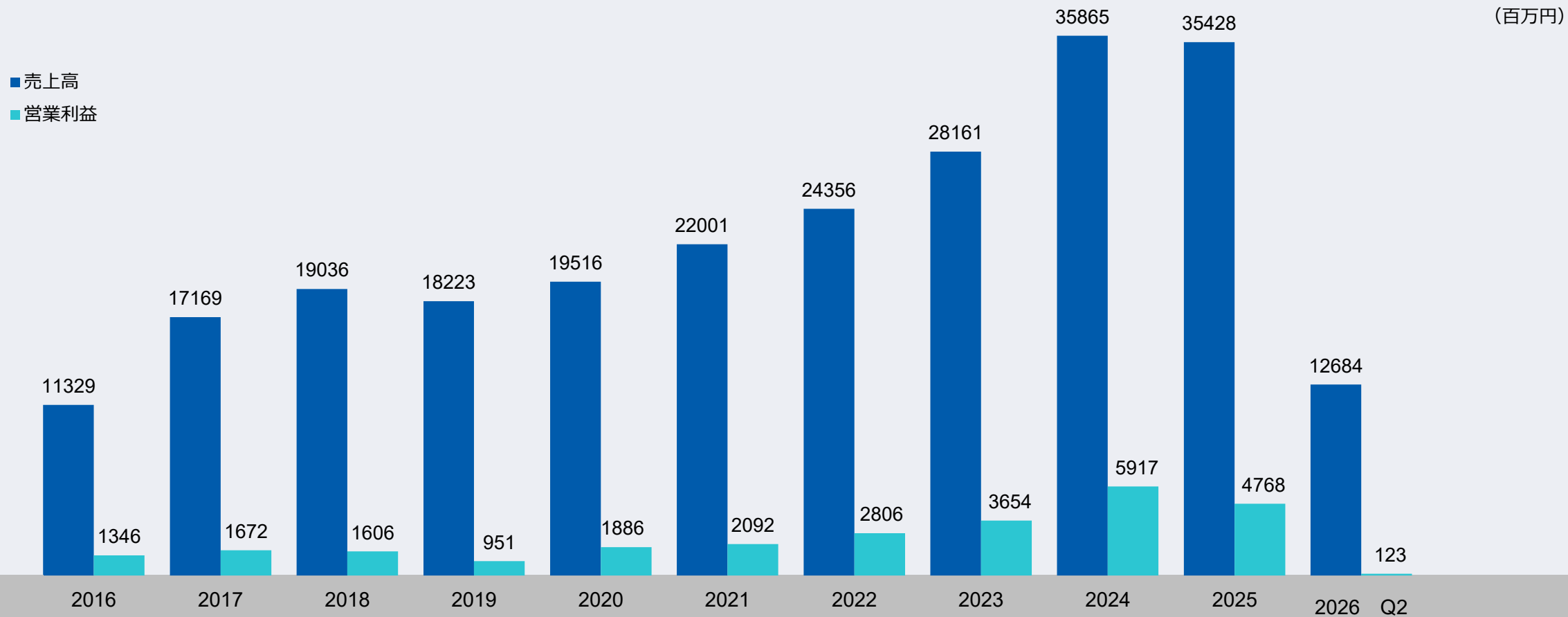
連結売上高・連結営業利益推移（四半期）

(百万円)



連結売上高・連結営業利益推移（通期）

TAZMO



(百万円)	2025年12月期	2026年12月期Q2	前期比増減
流動資産	37,809	38,383	573
固定資産	9,083	10,136	1,053
有形固定資産	7,812	8,876	1,063
無形固定資産	199	193	△5
投資その他資産	1,070	1,066	△4
総資産合計	46,893	48,520	1,626
流動負債	14,393	15,892	1,499
固定負債	5,462	5,720	257
負債合計	19,855	21,612	1,757
純資産合計	27,037	26,907	△130
自己資本比率	56.6%	54.4%	△2.2P

主な増減要因

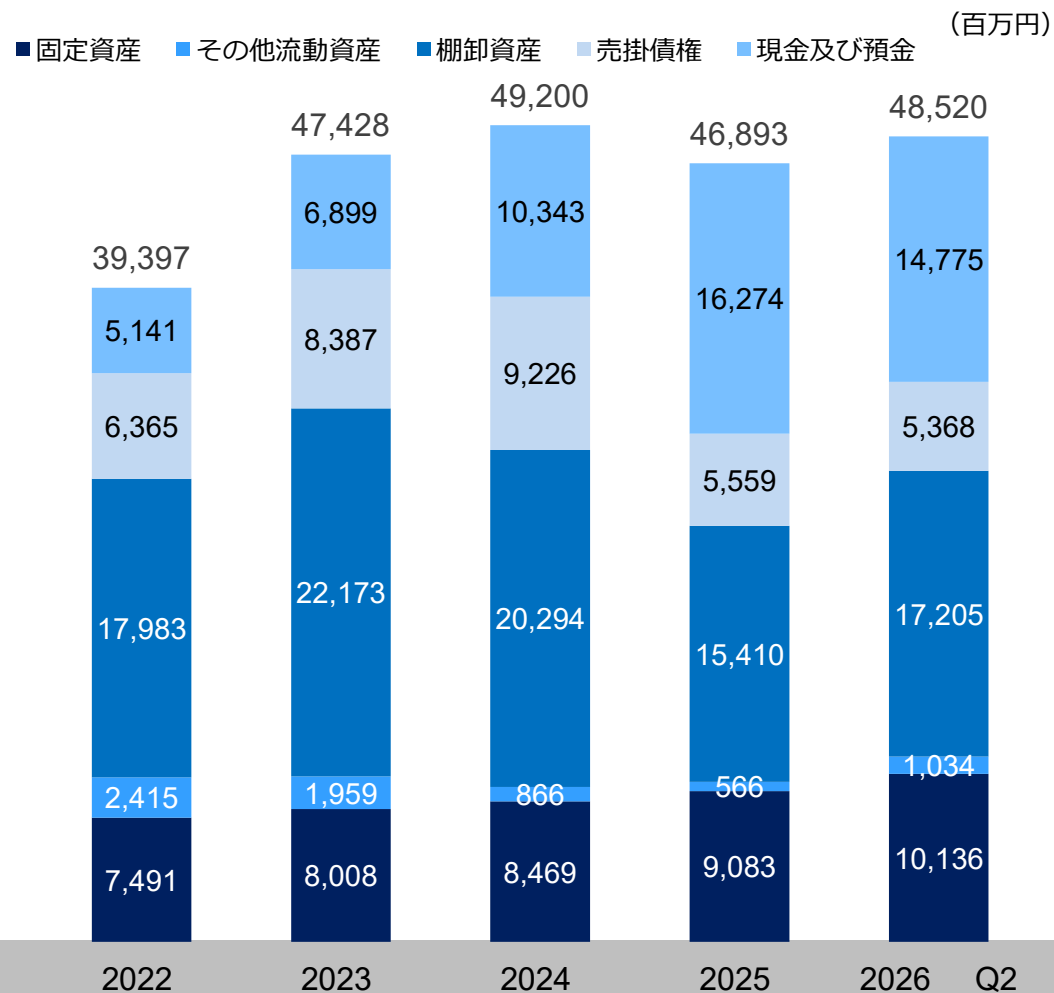
流動資産	(百万円)
現金及び預金	△1,498
受取手形及び売掛金	+397
電子記録債権	△588
仕掛品	+1,545
流動負債	
支払手形及び買掛金	+888
電子記録債務	△1,478
短期借入金	+321
未払法人税等	△676
契約負債	+2,557
固定負債	
長期借入金	+207

(百万円)	2025年12月期 Q2 実績	2026年12月期 Q2 実績	前年同期比 増減
営業活動による キャッシュ・フロー	4,394	△336	△4,730
投資活動による キャッシュ・フロー	△4,540	△290	4,249
フリー・キャッシュ・ フロー	△145	△626	△480
財務活動による キャッシュ・フロー	△556	7	564
現金及び現金同等物の 期末残高	8,719	13,456	4,737

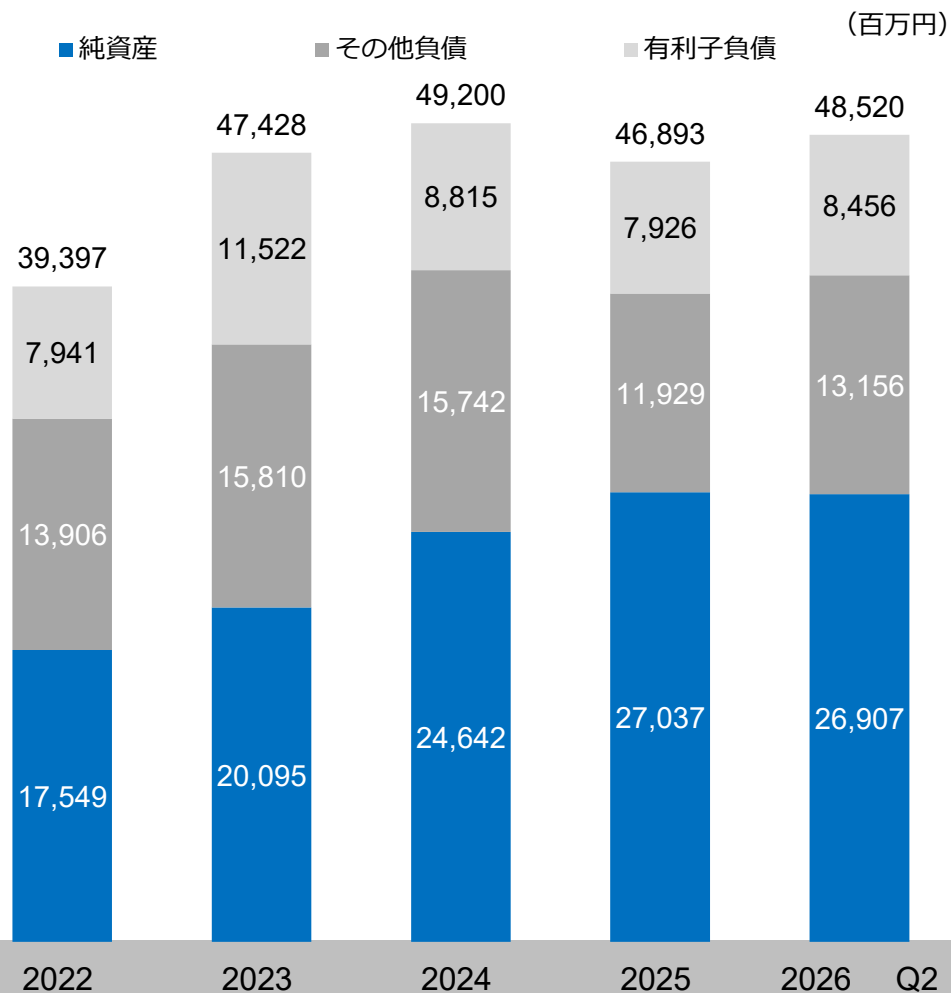
主な内訳

営業CF	(百万円)
税金等調整前当期純利益	270
棚卸資産の増減額（増加：△）	△1,676
契約負債（前受金）の増減額	2,401
法人税等の支払額	△826
投資CF	
定期預金の純増減額	1,056
有形固定資産の取得による支出	△1,327
財務CF	
長期借入れによる収入	2,000
長期借入金の返済による支出	△1,640
配当金の支払額	△497

資産



負債／純資産





2

セグメント別業績

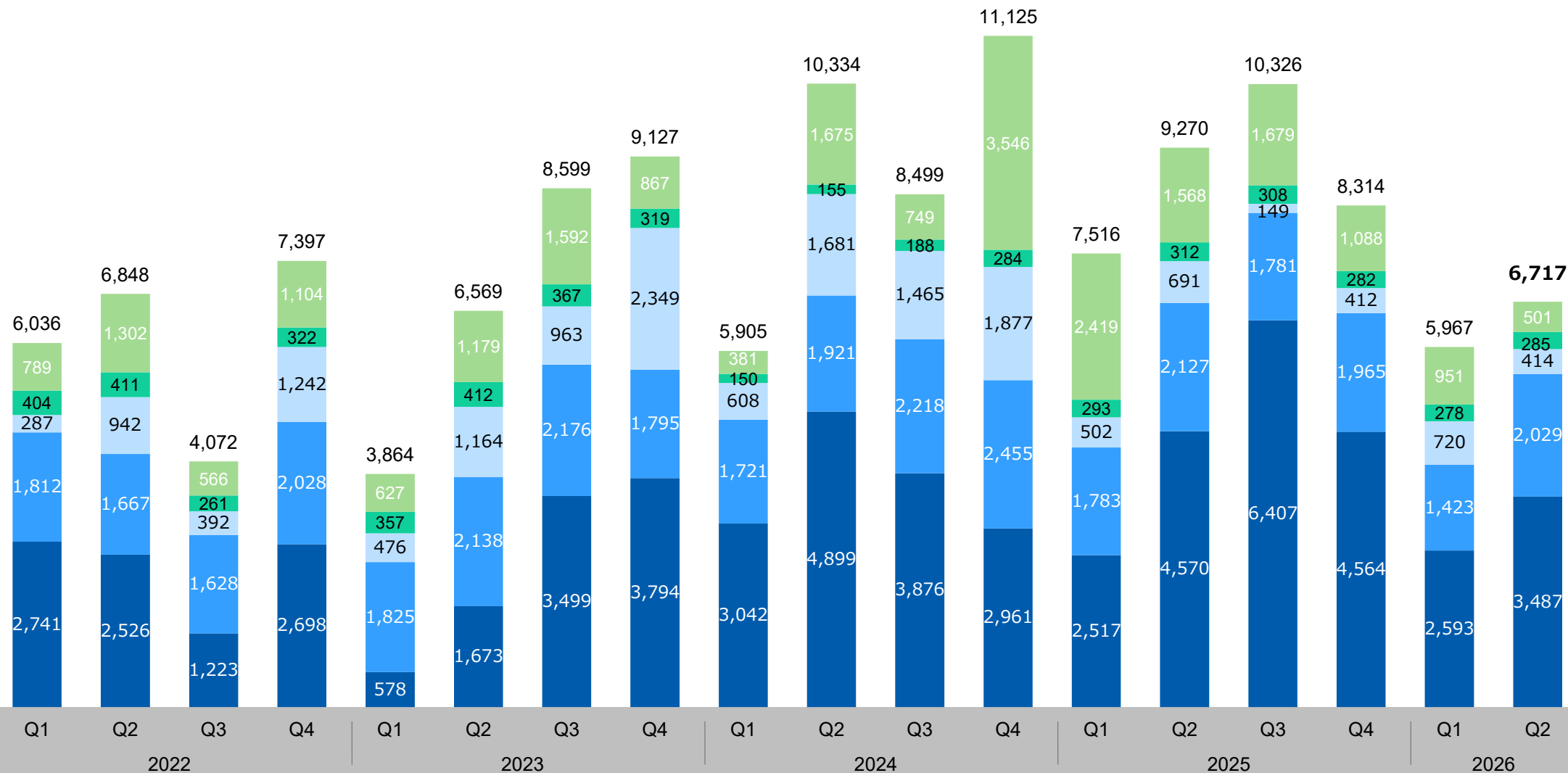
		2025年12月期 Q2 実績	2026年12月期 Q2 実績	前期比 増減率(%)	当初 2026年12月期 中間計画	中間計画比 (%)	2026年12月期 通期計画	通期計画比 進捗率(%)
(百万円)								
プロセス機器事業	売上高	12,193	10,668	△12.5	12,870	82.9	29,700	35.9
	営業利益	1,920	220	△88.5	900	24.5	3,400	6.5
	■ 半導体装置	売上高	7,088	△14.2	—	—	18,500	32.9
	■ 搬送装置	売上高	3,911	△11.7	—	—	8,860	39.0
	■ 洗浄装置	売上高	1,194	△4.9	—	—	2,340	48.5
金型・樹脂成形事業	売上高	606	563	△7.0	600	94.0	1,300	43.4
	営業利益	56	△2	—	30	—	70	—
表面処理用機器事業	売上高	3,987	1,452	△63.6	2,100	69.2	4,500	32.3
	営業利益	517	△89	—	△40	—	130	—
セグメント間連結調整		営業利益	24	△5	—	—	—	—
合計	売上高	16,787	12,684	△24.4	15,570	81.5	35,500	35.7
	営業利益	2,517	123	△95.1	890	13.8	3,600	3.4

※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、過去実績についても同様のセグメント区分で記載。

セグメント別 売上高推移（四半期）

■ 半導体装置 ■ 搬送装置 ■ 洗浄装置 ■ 金型・樹脂成形 ■ 表面処理用機器

(百万円)

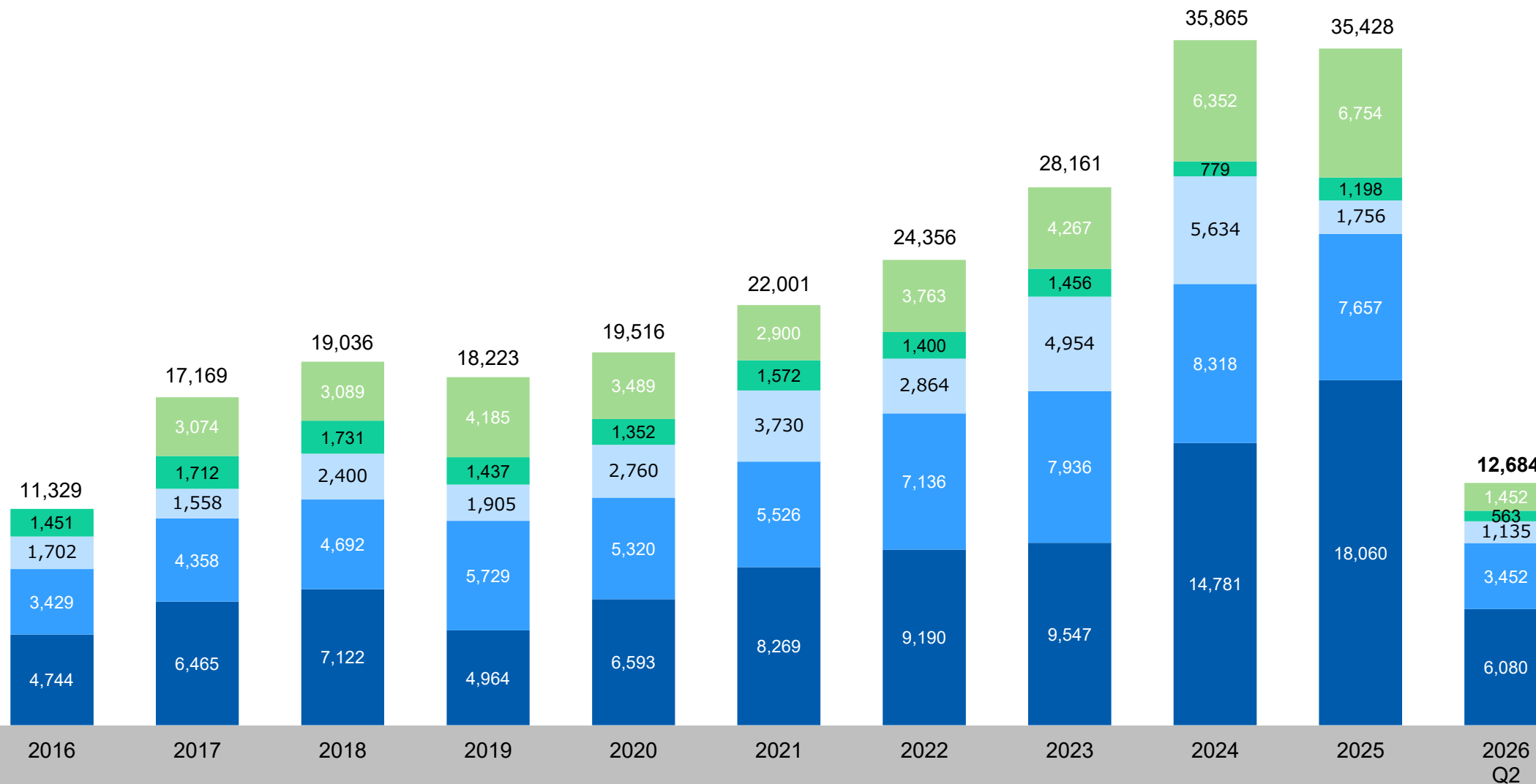


※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の売上高推移は補足資料参照。

セグメント別 売上高推移（通期）

■ 半導体装置 ■ 搬送装置 ■ 洗浄装置 ■ 金型・樹脂成形 ■ 表面処理用機器

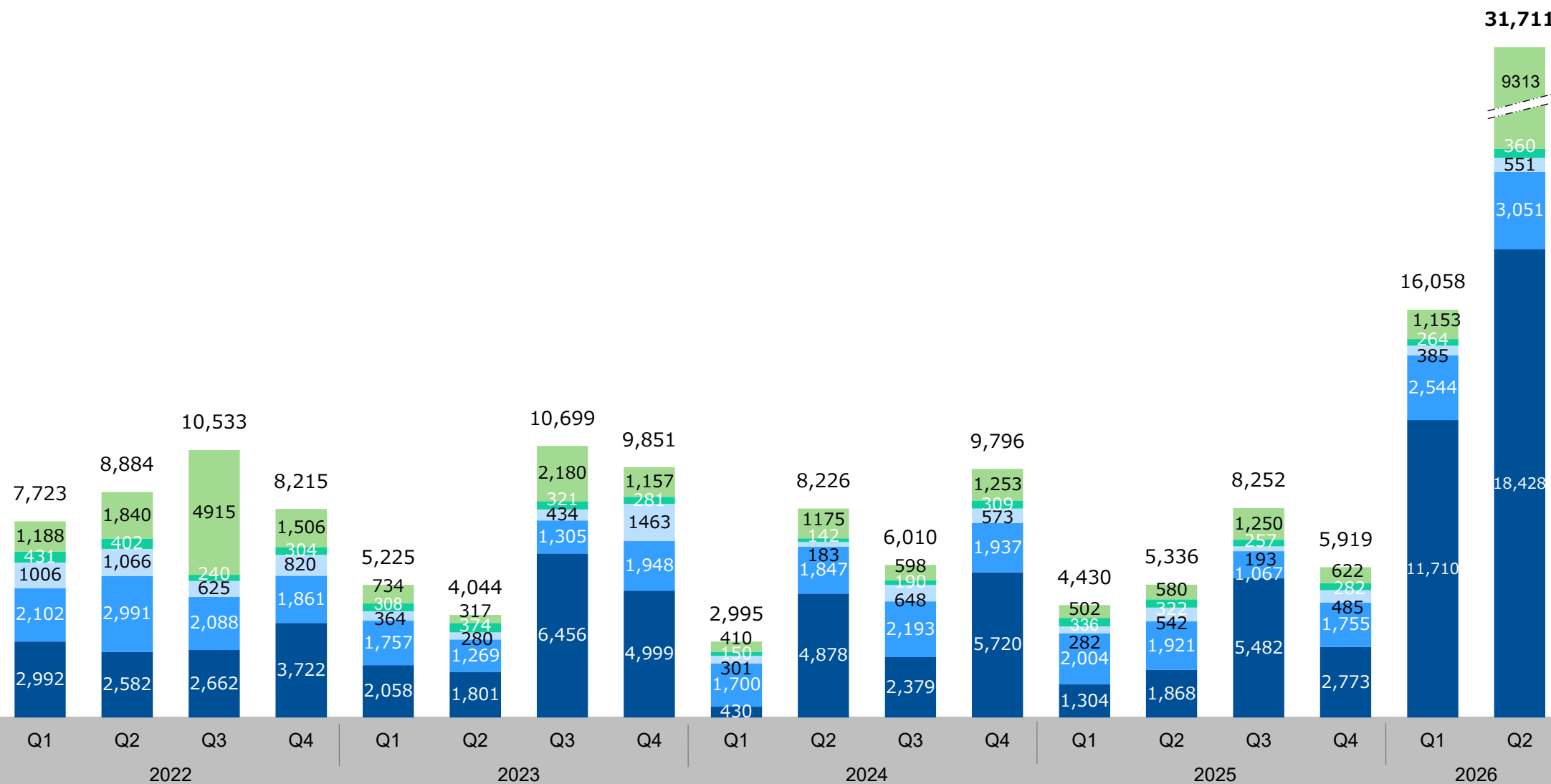
(百万円)



セグメント別 受注高推移（四半期）

■ 半導体装置 ■ 搬送装置 ■ 洗浄装置 ■ 金型・樹脂成形 ■ 表面処理用機器

(百万円)

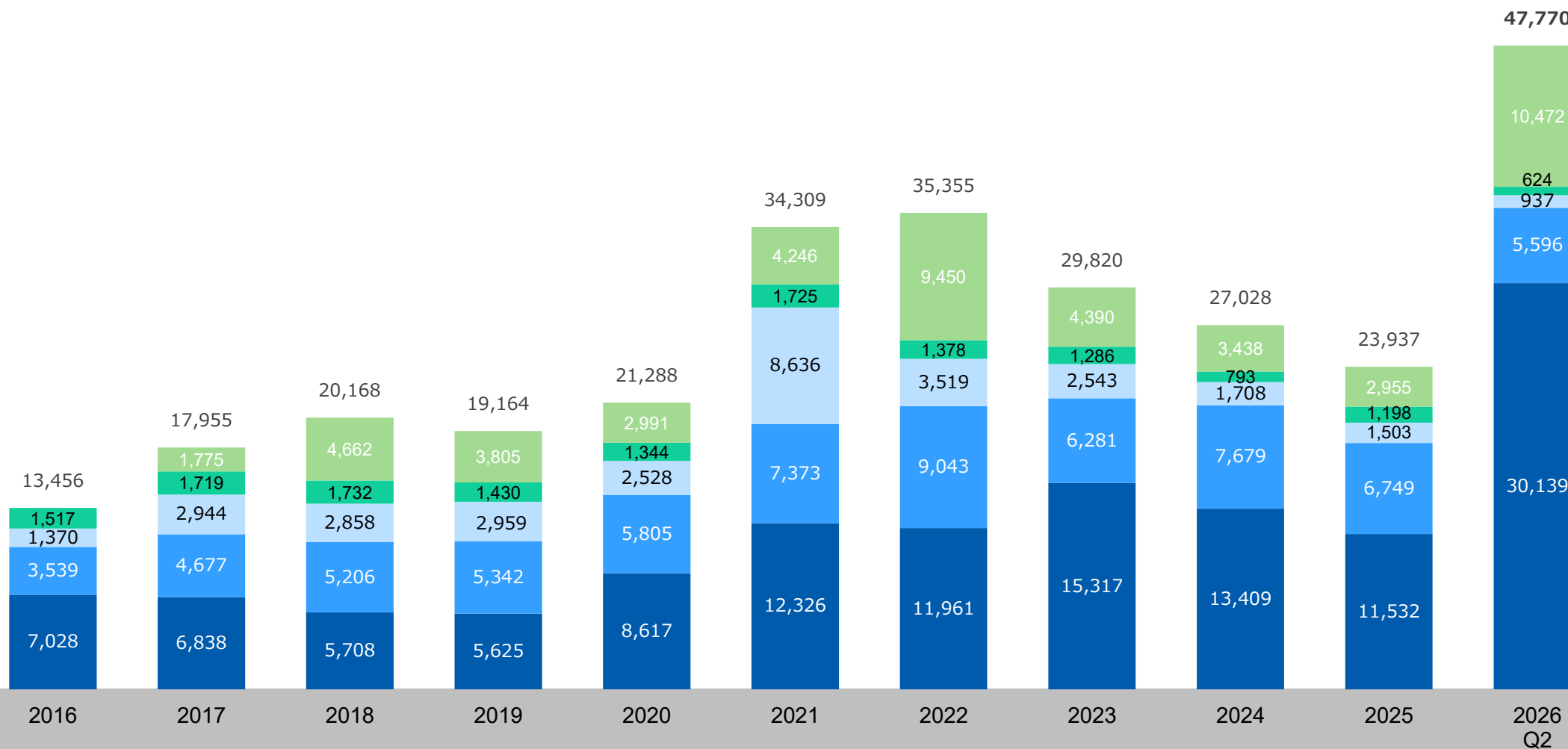


※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の受注高推移は補足資料参照。

セグメント別 受注高推移（通期）

■ 半導体装置 ■ 搬送装置 ■ 洗浄装置 ■ 金型・樹脂成形 ■ 表面処理用機器

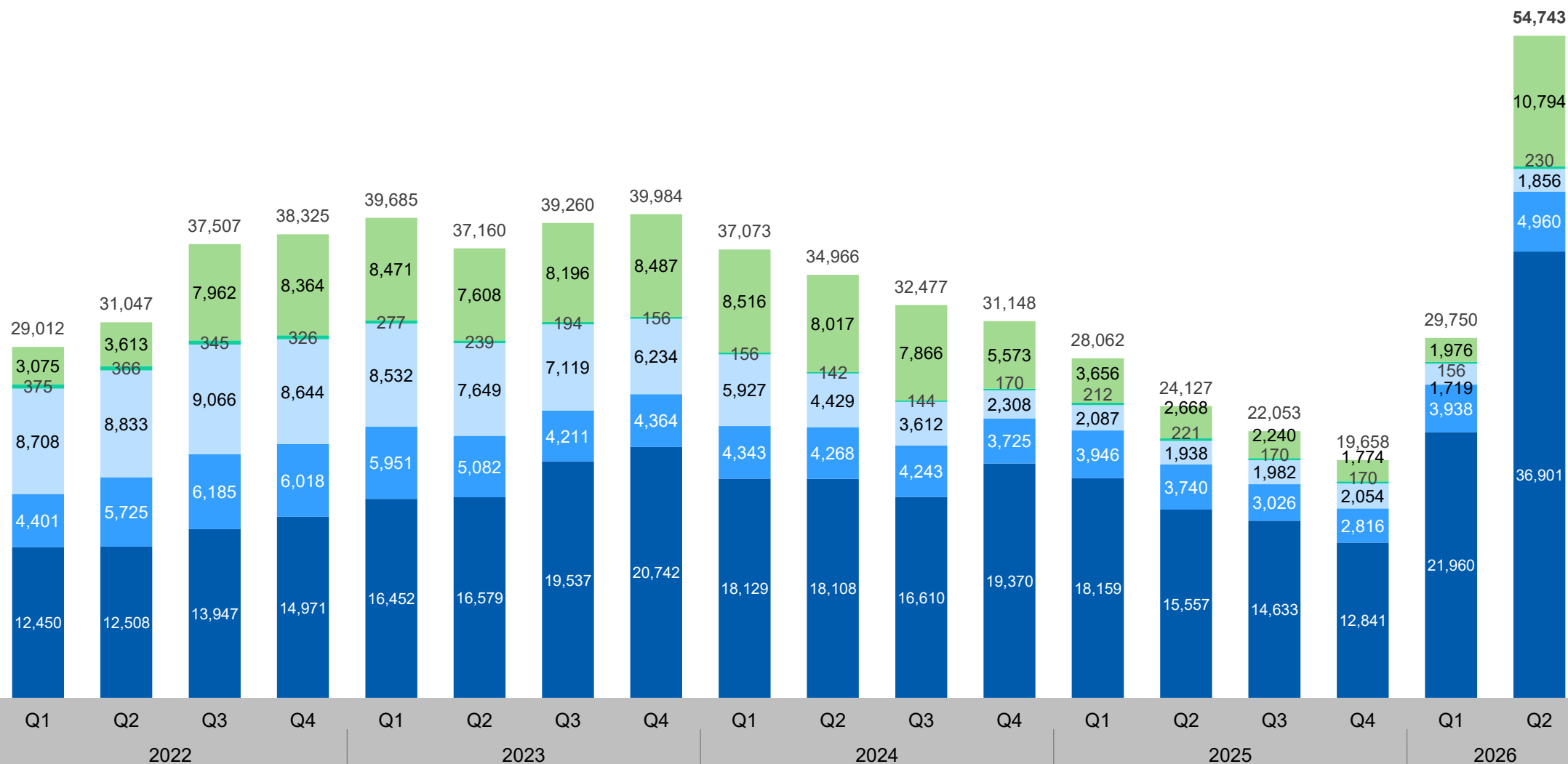
（百万円）



セグメント別 受注残高推移

■半導体装置 ■搬送装置 ■洗浄装置 ■金型・樹脂成形 ■表面処理用機器

(百万円)



※2026年12月期より、従来「コーター」セグメントに計上していた事業を「半導体装置」セグメントとの合算表記に変更したため、過去実績についても同様のセグメント区分で記載。従来表記の受注残高推移は補足資料参照。



3

市場（顧客）の状況

- 先端パッケージ向けWLP装置では、1Qで大きく受注したこともありQoQでの受注額は減少。一方、コーター/デベロッパーの受注が拡大した。今後の受注については市況に大きく左右されるが、引き続き期待している。パワー半導体向け装置では、引き合いは徐々に増加傾向にある。
- 先端パッケージ向けPLP装置では、塗布、剥離・洗浄など、これまで取り組んできたプロセスに対する引き合いが増加している。大小様々な引き合いであるが、確実に受注できるよう対応しており、更なる市場の拡大を期待している。
- 搬送装置では、引き合いが急増しており、受注額も増加してきた。部材の長納期化や個別要求への対応などの課題はあるが、国内外のサプライチェーンを強化し対応を進めている。
- スラリー供給装置の引き合いは増加しており今後の更なる受注に期待している。ウェーハ洗浄装置は新規案件の話も少なく回復には時間がかかると見ている。
- 表面処理用機器では、めっき処理を中心とするウェット処理装置および基板搬送装置共に、受注が拡大した。非常に活況なこの市場の状況を受けて、今後も期待している。

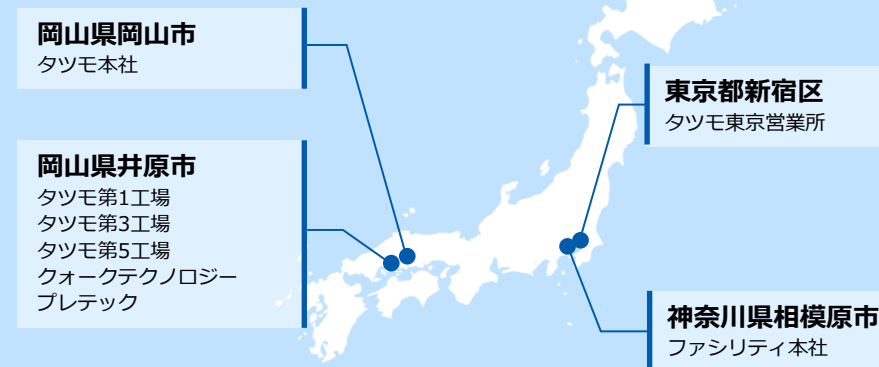


4

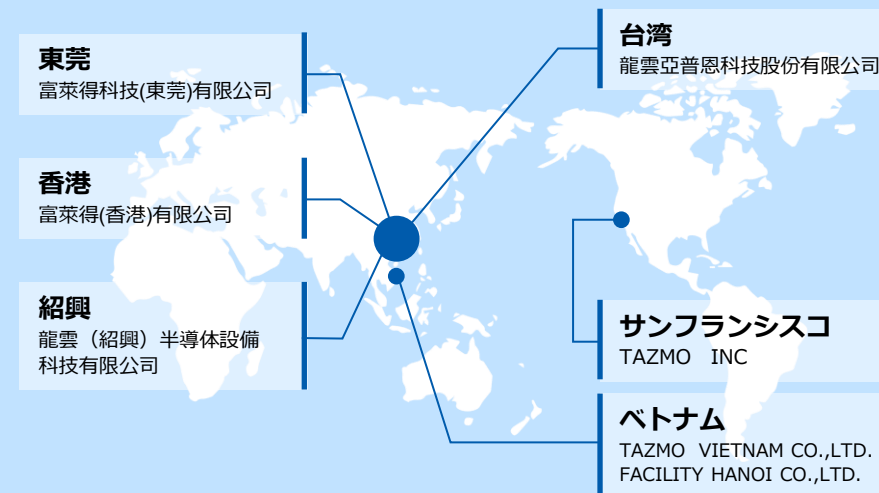
補足資料

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億5,689万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	6,279 名（2026年6月30日現在）
従業員数	単体 481名／連結 1,224名（2026年6月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

主要な国内拠点・関連子会社



主要な海外拠点



売上の8割近くを半導体関連（プロセス機器事業）が占めます。海外売上比率は約52%で、グローバルに展開する半導体装置メーカーです。

【2026年現在 会社概要】



グループ従業員数
連結・2026年6月30日現在

1,224名



創業
1972年

55年目



拠点数
国内11 + 海外12

23拠点



関連子会社数
国内・海外合計

14社

【2025年12月期 通期実績】



売上高
2025年12月期

354.2億円



営業利益
2025年12月期

47.6億円



営業利益率
2025年12月期

13.5%

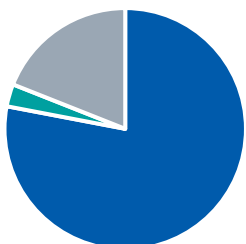


ROE
2025年12月期

14.0%



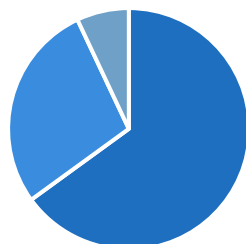
セグメント別 売上構成比
2025年12月期



プロセス機器（半導体関連） 78%
金型・樹脂 3%
表面処理 19%



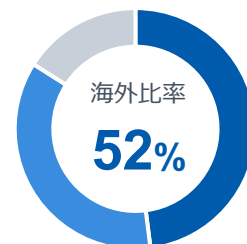
プロセス機器 売上構成比
2025年12月期



半導体装置 65%
搬送装置 28%
洗浄装置 7%



地域別売上構成比
2025年12月期



日本 48%
台湾 36%
その他 16%

海外比率
52%

事業の変遷と装置出荷台数の推移

1980年代に半導体装置へ参入。以降はFPD、パワー半導体、先端パッケージと時代のニーズに柔軟に対応。現在は販売の中心をOEMから直販へ転換、半導体製造のプロセス開発から関わっています。

①創業～1990年代

半導体装置事業に参入。OEMを中心としてウェットプロセスと搬送の技術を蓄積。

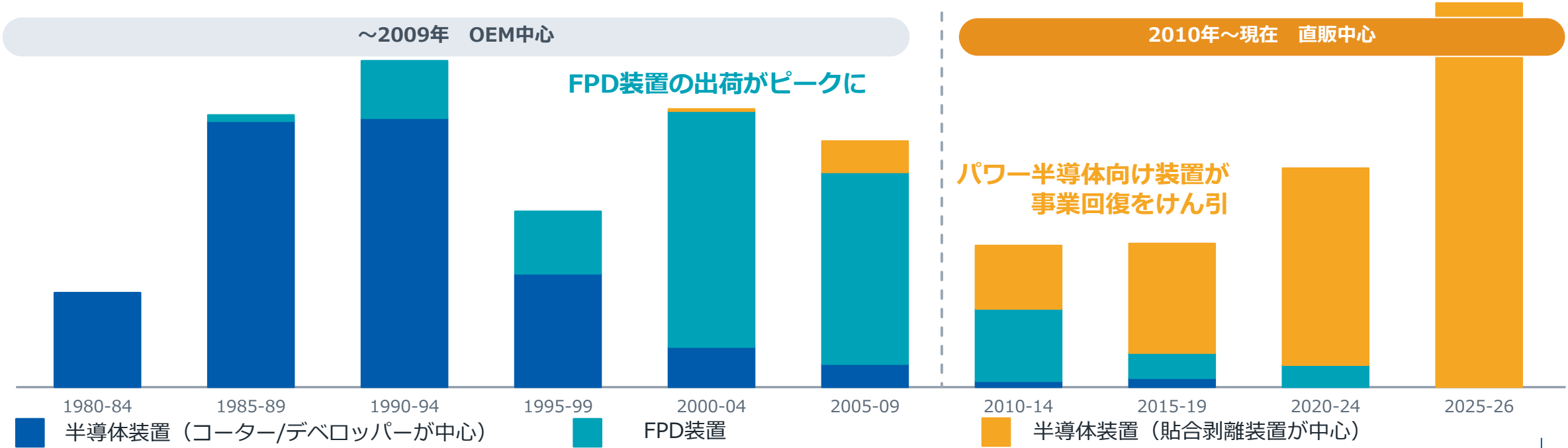
②2000年代

FPD装置(OEM)が事業の柱に。2000年代中盤が出荷台数のピーク。

③2010年代～現在

FPDから半導体装置へ。パワー半導体、先端パッケージへ広がり、販売もOEM中心から直販中心へ転換。

■主力製品群別 期間ごとの平均出荷台数の推移



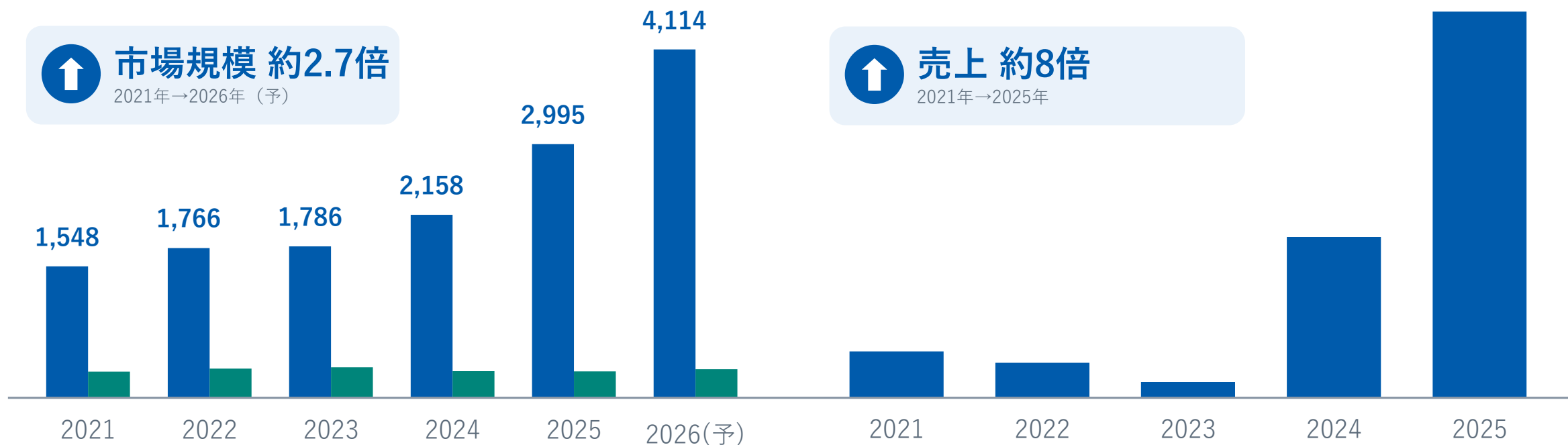
※2025-26年の出荷台数には2026年12月期の予測値を含む。 © 2024 TAZMO Co.,Ltd.

AI向けロジック半導体の市場規模拡大により、タツモの先端パッケージ向け貼合剥離装置の売上が大幅に成長。要求される技術水準が高まるロジック半導体製造にタツモの装置は使われています。

■ ロジック半導体とパワー半導体の市場規模比較

■ タツモ先端パッケージ向け装置 売上推移

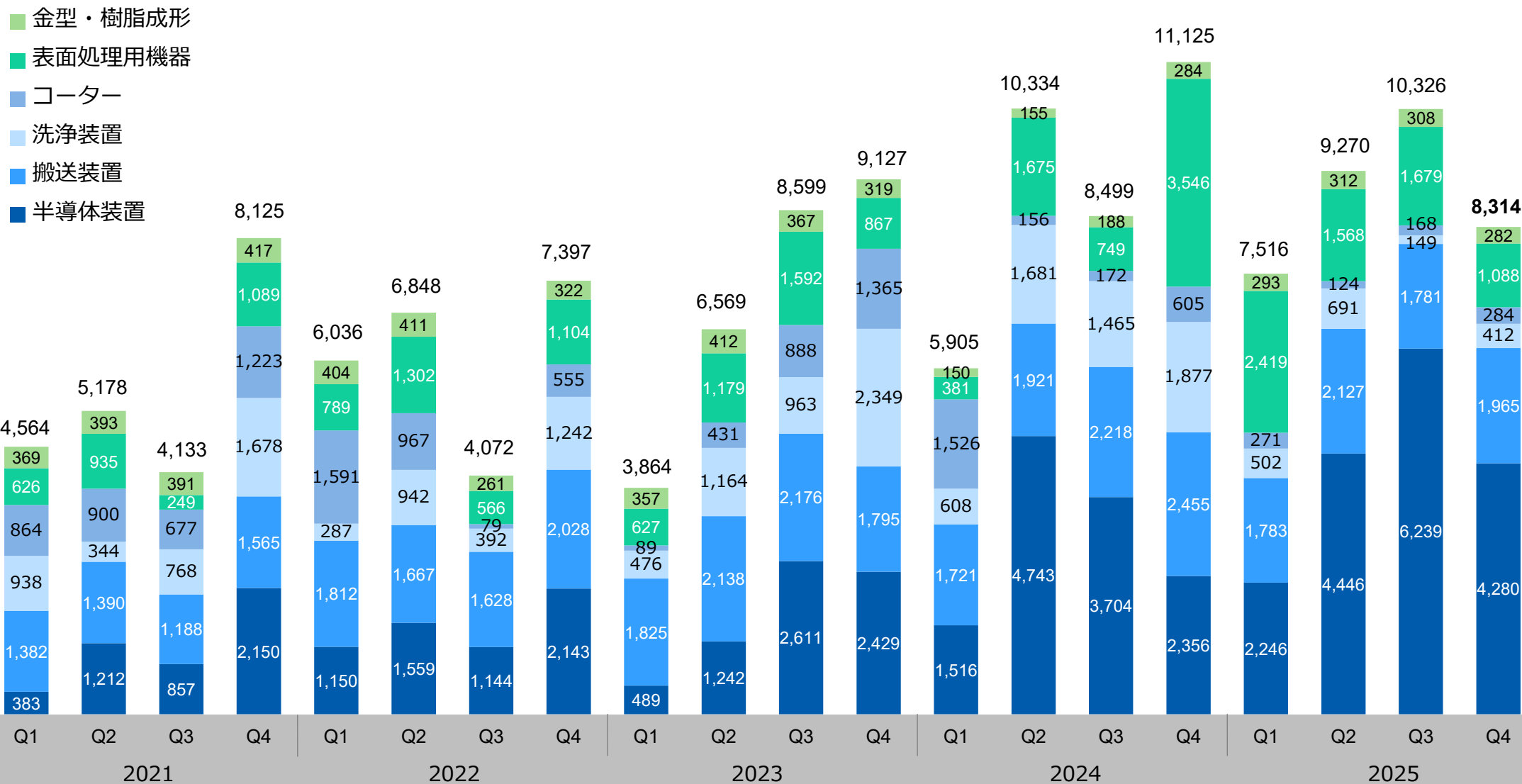
■ ロジック半導体 ■ パワー半導体（ディスクリート）



出典：WSTS（2021～2025年は実績、2026年は2026年春季予測 2026年6月）。
※ディスクリートはパワー半導体を中心とする区分。
※単位：億ドル

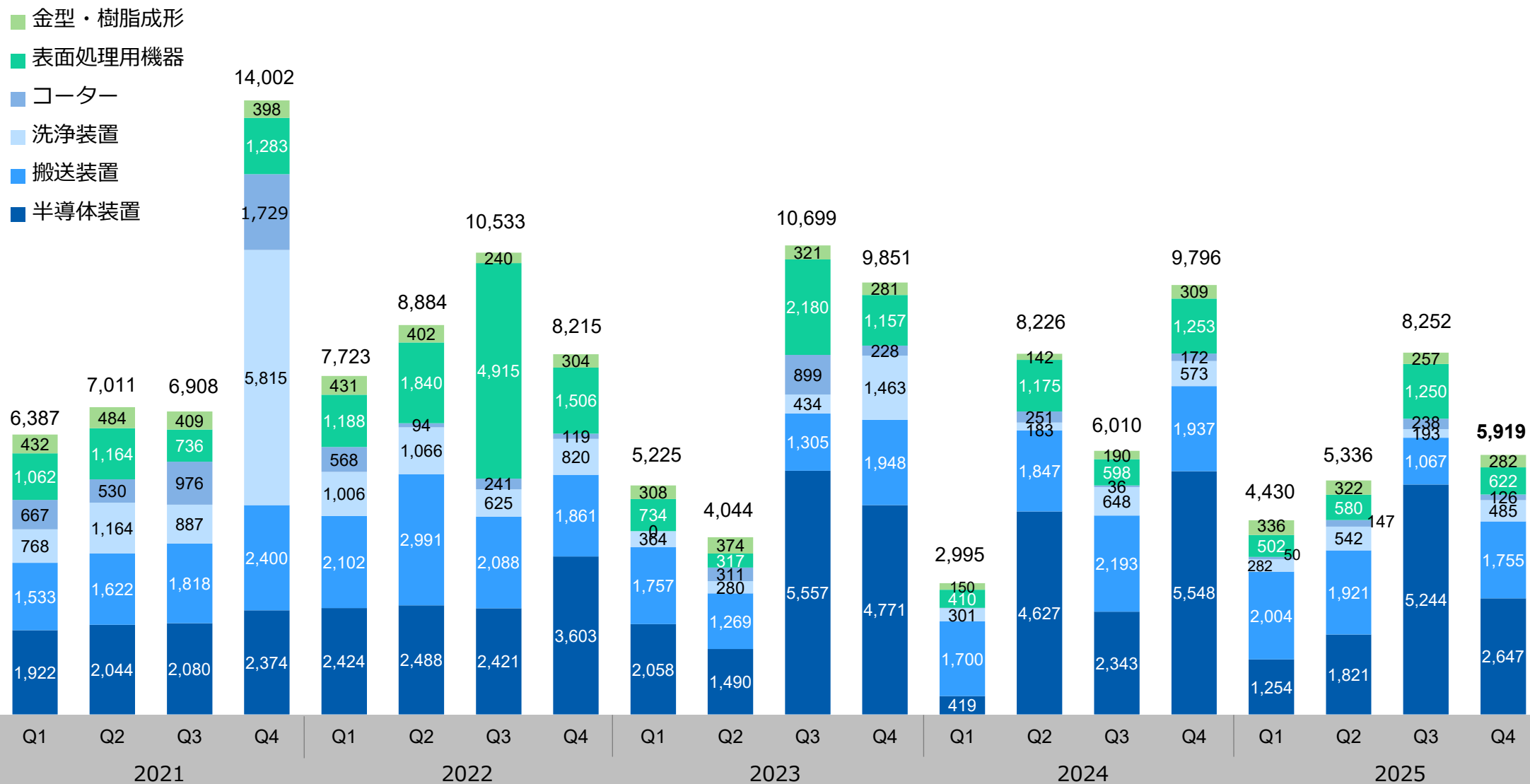
従来セグメント別 売上高推移（四半期）

(百万円)



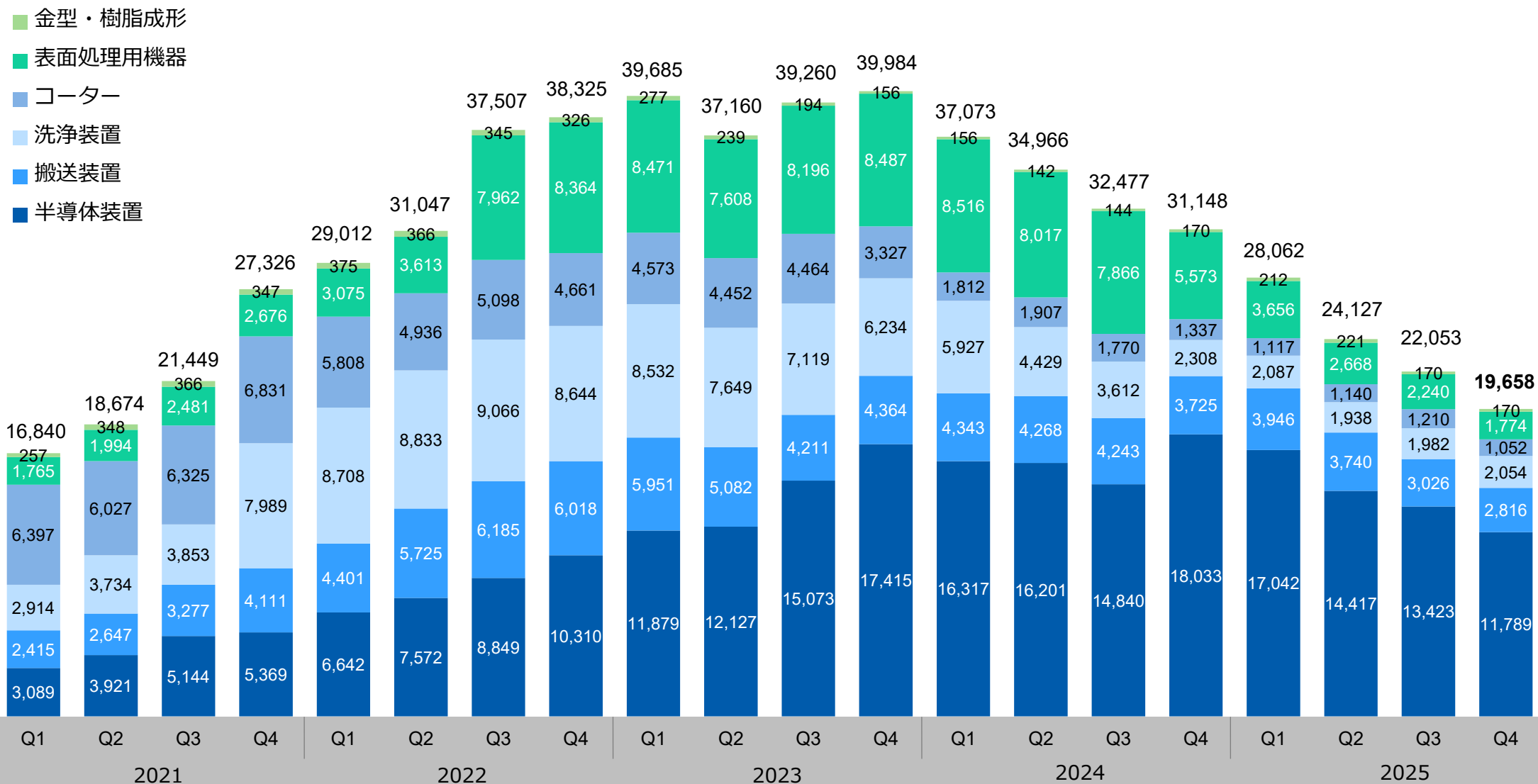
従来セグメント別 受注高推移（四半期）

(百万円)



従来セグメント別 受注残高推移

(百万円)



- | | |
|---|--|
| <p>1972 ● - 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立</p> <p>1980 ● - インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始</p> <p>1989 ● - 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始</p> <p>1990 ● - 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始</p> <p>1994 ● - エンボスキャリアテープの製造・販売を開始</p> <p>1995 ● - インジェクション成形品の製造・販売を開始</p> <p>2001 ● - 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始</p> <p>2004 ● - JASDAQ市場に株式を上場</p> <p>2008 ● - TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立</p> | <p>2009 ● - 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結</p> <p>2013 ● - アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築</p> <p>2017 ● - 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化</p> <p>2018 ● - 東京証券取引所市場第一部へ市場変更</p> <p>2019 ● - 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転</p> <p>2020 ● - アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併</p> <p>2022 ● - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立</p> |
|---|--|

半導体装置事業

貼合・剥離装置

- 先端パッケージ向け装置（WLP ※1／PLP ※2）
- パワー半導体向け装置



高性能チップの製造に欠かせないウェーハの薄化を実現する仮接合・剥離装置の開発・設計・製造・販売を行っています。ウェーハにガラス支持体を貼り合わせることで、ウェーハの損傷を防ぎながら薄化が可能です。

厚膜塗布・現像装置

FPD製造装置の開発・製造で培った知見をもとに、均一な薬液の塗布の実現と、現像装置で露光された部分のみを洗い流すことで精密な回路作りを可能にしています。

※1 WLP：ウェーハレベルパッケージ
※2 PLP：パネルレベルパッケージ

搬送装置事業

- 半導体装置メーカー向け（ウェーハ、マスクなどに対応）



半導体製造装置内で使用される搬送ロボットや、ユニットをフレームに組み込んだEFEMなどの開発・設計・製造・販売を行っています。

洗浄装置事業

ウェーハメーカー向けの枚葉洗浄装置のほか、スラリー供給装置、廃液からリン酸を再生・再利用する装置の開発・設計・製造・販売を行っています。

金型・樹脂成形事業

コネクタメーカー向けに精密金型や樹脂成形品を提供。

表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供を行っています。

本資料の取扱上の注意

本資料には機密情報が含まれています。
弊社の書面による承諾無しに複写、又は第三者への開示は出来ません。
何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経理部IR課



086-239-5000



086-239-5100



keiki@tazmo.co.jp